

附件 1

成都市集成电路行业协会 产业投融资工作委员会成立方案

一、分支机构名称

成都市集成电路行业协会产业投融资工作委员会

二、成立背景

当前成都集成电路产业营收已突破千亿元、稳居中西部首位，但对标全国一流集聚区，产业仍面临**产业链结构失衡、融资供需错配、投引联动不畅、产业生态协同不足**等突出问题。集成电路企业研发投入大、周期长、轻资产、风险高，全生命周期融资体系尚不健全，中小科创企业普遍存在“融资难、融资贵、融资慢”瓶颈；资本与产业、招商脱节，“以投带引、以引促投”市场化闭环尚未形成，“科研—产业—资本—市场”全链条存在堵点，本地顶尖科研资源成果转化率不足 20%，龙头企业与中小微企业配套联动薄弱。

为破解上述产业痛点，抢抓国家战略机遇，成都市集成电路行业协会拟设立“成都市集成电路行业协会产业投融资工作委员会”（以下简称“委员会”）。委员会将作为协会服务会员、赋能产业的专业化分支机构，整合基金、券商、创投、银行等多元金融资源，搭建产融精准对接平台，构建覆盖企业全生命周期的投融资服务体系，推动产业链、资本链、创新链深度融合，助力成都打造西部集成电路产业高地。

三、委员会性质

委员会在自愿、平等、互利、合作的基础上，由成都市集成电路行业相关的投融资机构（包括股权投资机构、基金、券商、银行、保险、担保、租赁等）、有投融资需求的集成电路企业、以及相关中介服务机构等组成。投融资委员会隶属于成都市集成电路行业协会（以下简称“协会”），不具有法人资格，是协会的分支机构，接受协会的领导和管理。

四、委员会宗旨

委员会严格遵守成都市集成电路行业协会章程所规定的宗旨和业务范围，秉承“政府引导、市场运作、自愿参与、开放共享、协同共赢”的宗旨，依托协会平台优势和投融资机构专业资源，为集成电路企业提供融资对接、资本规划、政策辅导、上市培育等服务；为政府和会员单位提供行业投融资研究、政策建议；在政府、企业和金融机构之间发挥桥梁纽带作用，促进技术与资本的双向奔赴，推动成都市集成电路产业生态持续优化。

五、发起单位

委员会发起单位不超过 30 家，涵盖成都市国资平台、产业链重点企业、头部投资机构、重点金融机构、专业服务机构等。发起单位即为协会会员，承认本协会章程，承诺履行章程规定的各项义务，支持委员会发起成立。

六、组织架构

委员会在成都市集成电路行业协会统一领导下开展工作，并对协会理事会负责。

（一）负责人设置

委员会设主任委员 1 名（分支机构负责人）、副主任委员若干（不超过 30 人）。主任委员不得同时担任本协会其他分支机构的主任委员。

（二）产生程序

主任委员、副主任委员候选人由协会负责人从委员会发起单位的主要负责人中推荐，经协会秘书处考察审核，并征求协会党组织意见后，提交理事会以无记名投票方式表决产生。

（三）内部架构

委员会可通过召开委员会会议等研究决定重要事项，可设置相关办事岗位或部门。委员会下设秘书处工作，由协会秘书处投融资服务部（或专委会管理部）负责日常协调与管理。

（四）任期与考核

委员会负责人任期原则上不超过 5 年，任职年龄不超过 70 周岁。协会建立负责人年度工作述职和评价考核制度，对连续两年评价不合格的负责人予以撤换。

七、组建流程

（一）拟定委员会成立方案，征集并拟定委员会发起单位名称、主任委员和副主任委员候选人名单；

（二）方案及名单征求协会党组织意见，并报业务指导单位（成都市经信局市新经济委）和登记管理单位（成都市民政局）同意；

（三）将委员会成立方案、发起单位名称及主任委员和副主

任委员候选人名单，提交协会理事会审议，以无记名投票方式进行表决，形成会议记录并留存资料；

（四）协会在上述表决通过后 10 个工作日内对外发布公告，接受社会监督；

（五）公开征集投融资委员会其他成员单位，成员纳入协会统一会员管理；

（六）委员会正式挂牌运营，召开首次委员会会议，讨论确定工作规划，并开展相关工作；

（七）按规定完成协会重大事项报备以及民政部门分支机构备案手续。

八、运行机制

（一）信息共享机制（核心支撑）

以“共建、共享、动态更新、分级开放、精准匹配”为原则，构建项目库、资本库、专家库、信息库四大核心资源库+线上智能匹配平台体系：

1. 项目库：按产业链细分领域、发展阶段实行 A、B、C 三级分类管理，规范入库审核、动态更新、分级开放流程，成员单位享有信息优先对接权；

2. 资本库：按股权投资、债权融资、专业服务三类收录，精准画像机构投资偏好、服务范围，定期开展项目-资本智能匹配，重点项目组织专项闭门对接；

3. 专家库：按技术、产业、投资、政策合规、资本市场五类入库，实行 5 年任期制考核，采用“常年顾问+专项服务”模式，

为委员会提供智库支撑；

4. 信息库：归集政策、行业、委员会、服务四大类信息，实行每周更新、每月推送简报、每季度发布运行简报、每年发布产业报告，为成员提供全维度信息服务。

（二）联合投资机制（核心业务）

紧扣产业补链强链方向，构建“项目初选-立项评审-联合尽调-方案设计-投资落地-投后管理-退出管理”全生命周期联合投资机制，采用“领投+跟投”核心模式：

1. 项目筛选立项：每月从项目库中筛选符合产业导向的优质项目，重点聚焦短板领域，组织专家开展立项评审，通过后纳入联合投资项目池；

2. 联合尽调方案：组织意向机构、技术、法务、财务专家开展联合尽调，分工负责、成果共享，形成尽调报告；由领投机构牵头设计投资方案，明确投资模式、核心条款、落地成都相关要求；

3. 投资落地风控：各参与机构按协议落实出资，委员会秘书处全程协调；实行风险共担、收益共享，建立分级风控、决策回避、风险预警全流程防控体系，落地项目优先匹配市、区两级扶持政策；

4. 投后赋能退出：领投方牵头日常投后管理，委员会同步提供产业链对接、技术支持、上市辅导等全周期赋能服务，为项目提供 IPO、并购重组等多元化退出渠道支持。

（三）招引联动机制（核心目标）

联合市、区两级投促部门，构建“全域招商图谱-线索归集-分级研判-资本赋能-落地服务-绩效评估”全流程投招闭环机制：

1. 线索归集管理：制定全域招商图谱，明确靶向招引方向；建立“六位一体”项目线索归集渠道，实行“一个项目、一个编号、全程跟踪”台账管理；

2. 分级研判赋能：按项目投资规模、产业带动作用实行三级研判，重大项目成立攻坚专班；对意向落地项目，通过联合投资锁定落地意向，提前匹配政策支持；

3. 全流程落地服务：对落地项目实行“一项目一专班”，提供选址、注册、政策申报等全流程保姆式服务，统筹全市载体与政策资源，实现最优配置；项目落地后持续提供全周期赋能服务；

4. 激励绩效评估：每年开展招商绩效评估，对贡献突出的单位和个人予以激励。

（四）活动交流机制（核心载体）

建立常态化、品牌化活动体系，打造核心 IP，凝聚合力、提升影响力：

1. 月度专题沙龙/培训：每月围绕政策解读、投融资实操、上市辅导、技术研讨等主题，开展常态化赋能服务；

2. 季度细分赛道闭门路演会：每季度聚焦 1 个细分赛道，筛选 10-15 个优质项目路演，推动资本与项目精准对接；

3. 半年产业链供需对接会：上半年举办龙头企业配套专场，下半年举办产学研成果转化专场，推动供应链本土化与科研成果

转化；

4. 年度集成电路产业投融资大会：每年举办 1 次行业标杆性大会，发布产业报告与专委会工作报告，举办重大项目集中签约，打造西部行业核心品牌活动；

5. 专项交流活动：每年组织跨区域对标学习、企业参访、行业展会参展、国际合作交流等活动，拓展行业资源。

九、经费管理

（一）会费管理

1. 委员会不单独制定会费标准、不单独收取会费；

2. 委员会发展的成员属于协会会员，按协会统一会费标准缴纳会费，由协会开具统一会费票据；

3. 严禁向同一会员重复收费，严禁截留、挪用会费收入。

（二）运营经费

1. 委员会全部收支纳入协会财务统一核算管理，不单独开设银行账户；

2. 委员会发起单位自愿提供的启动资金，纳入协会统一管理，专项用于委员会初期运营；

3. 专项活动经费由参与单位自愿分担，或通过合作机构合法赞助（纳入协会统一核算）；

4. 探索为产业提供深度投融资服务收取合理服务费，收入归协会所有，反哺委员会运营；

5. 委员会经费使用实行专款专用、预算管理、分级审批、公开透明，接受协会监事会与会员监督。